GT30L32S4W 标准汉字字库芯片

简要说明 BRIEF



■ 字符集: GB2312

■ 字号: 12x12、16x16、24x24、32x32 点阵

■ 排置方式: 横置横排

■ 总线接口: SPI 串行总线

■ 封装类型: SOP8-B

V 1.0

2013-04



目 录

1	[概述	3
1.1	.1 芯片特点	3
1.2	.2 芯片内容	4
1.3	.3 字型样张	5
2	2 操作指令	11
2.1	2.1 指令参数	11
2.2	2.2 Read Data Bytes(一般读取)	11
2.3	2.3 Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)	212
3	3 引脚描述与接口连接	13
3.1	3.1 引脚配置	13
3.2	3.2 引脚描述	13
3.3	3.3 HOST CPU 主机接口与 SPI 接口电路示意图	14
4	I 电气特性	15
4.]	l.1 绝对最大额定值	15
4.2	.2 DC 特性	15
4.3	-3 AC 特性	15
	5 封装尺寸: SOP8-B	17
6	ó 附录	18
	5.1 GB2312 1 区字符 (846 字符)	18
6.2	5.2 8×16 点国标扩展字符(126 字符)	21
	(20.16 与韩环宫族 (64 宫族)	22



1 概述

GT30L32S4W是一款内含12x12点阵、16x16点阵、24x24点阵、32x32点阵的汉字库芯片,支持GB2312 国标汉字(含有国家信标委合法授权)及ASCII字符。排列格式为横置横排。用户通过字符内码,利用本 手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,可从该地址连续读出字符点阵信息。

1.1 芯片特点

● 数据总线: SPI 串行总线接口

● 点阵排列方式:字节横置横排

● 访问速度: SPI 时钟频率: 80MHz(max.)

● 工作电压: 2.7V~3.6V

● 电流: 工作电流: 13mA

待机电流: 1uA





1.2 芯片内容

分类	字库	字号	字符数	字体	排列方式	备注
	ASCII	5x7	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	7x8	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	6x12	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	8x16	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	12x24	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	16x32	96	标准	W-横置横排	
	ASCII	12 点阵不等宽	96	Arial (方头)	W-横置横排	
ASCII	ASCII	12 点阵不等宽	96	Times new Roman(白正)	W-横置横排	
字符集	ASCII	16 点阵不等宽	96	Arial(方头)	W-横置横排	
	ASCII	16 点阵不等宽	96	Times new Roman(白正)	W-横置横排	(A)
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Arial (方头)	W-横置横排	
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Times new Roman(白正)	W-横置横排	
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Arial (方头)	W-横置横排	
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Times new Roman(白正)	W-横置横排	
		12x12	6763	宋体	W-横置横排	
	GB2312	16x16	6763	宋体	W-横置横排	
	汉字	24x24	6763	宋体	W-横置横排	
		32x32	6763	宋体	W-横置横排	
		12x12	846	宋体	W-横置横排	
汉字	GB2312	16x16	846	宋体	W-横置横排	
字符集	字符	24x24	846	宋体	W-横置横排	
		32x32	846	宋体	W-横置横排	
		6x12	126	宋体	W-横置横排	
	国标扩	8x16	126	宋体	W-横置横排	
	展字符	12x24	126	宋体	W-横置横排	
		16x32	126	宋体	W-横置横排	

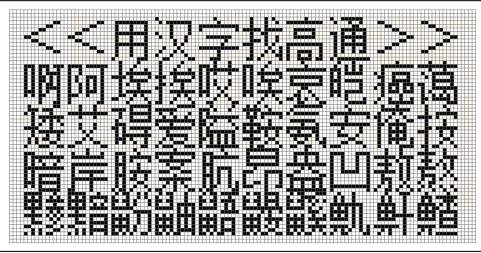
G□T●P高通[®] -4- www.genitop.com



1.3 字型样张

1.3.1 汉字字符

12x12 点阵 GB2312 汉字

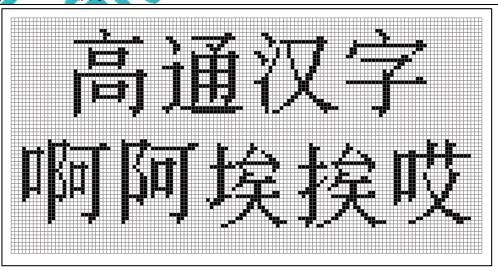




16x16 点阵 GB2312 汉字

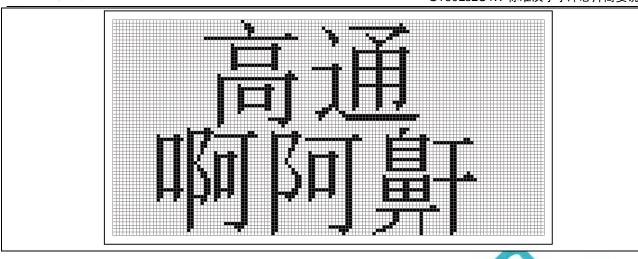


24x24 点阵 GB2312 汉字

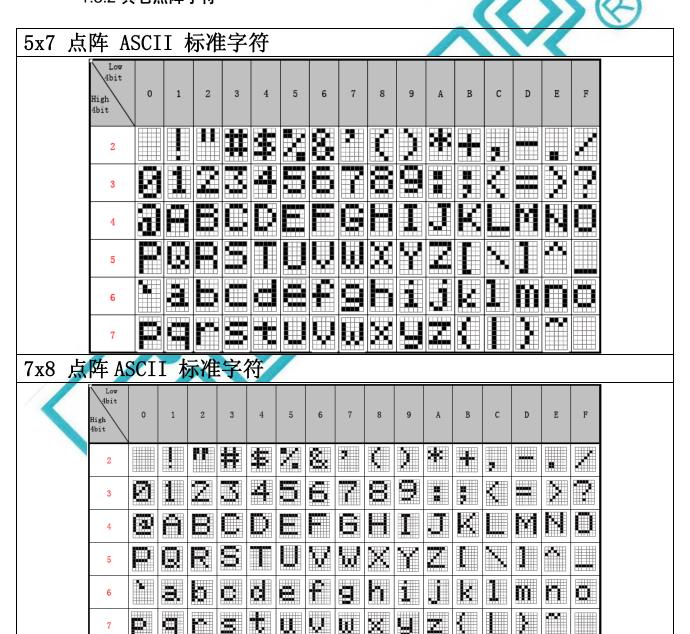


32x32 点阵 GB2312 汉字



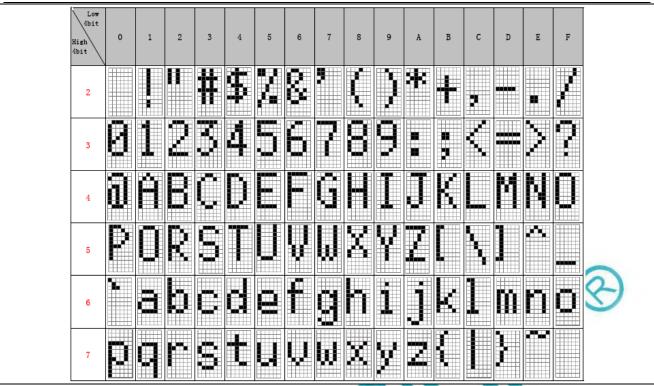


1.3.2 其它点阵字符

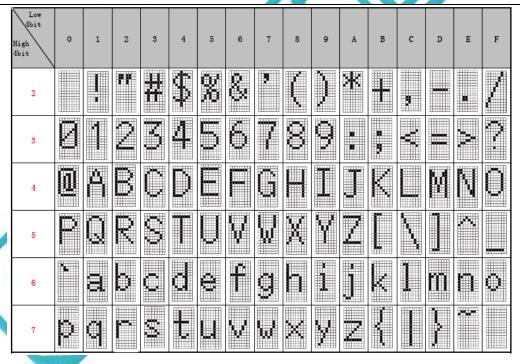


6x12 点阵 ASCII 标准字符



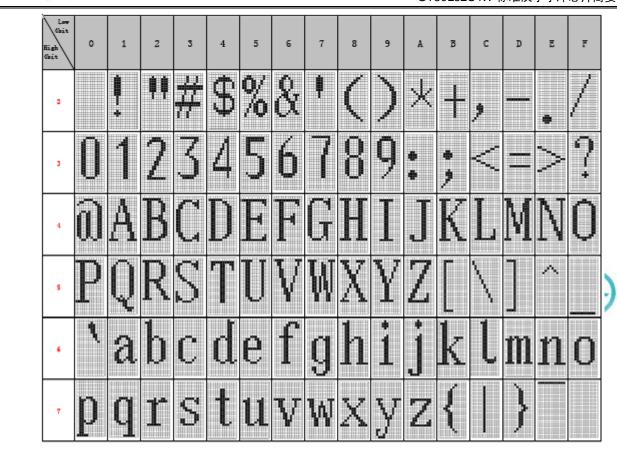


8x16 点阵 ASCII 标准字符

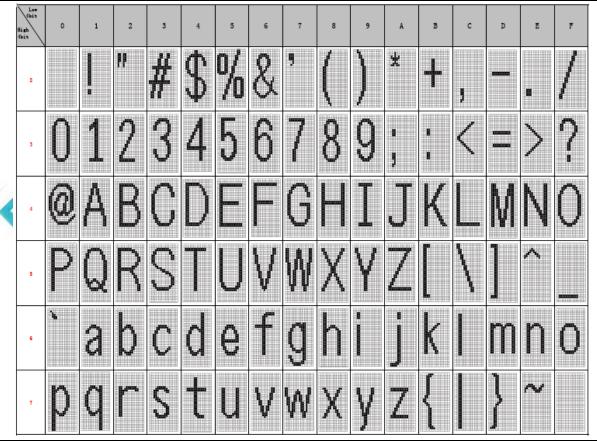


12x24 点阵 ASCII 标准字符





16x32 点阵 ASCII 标准字符



12 点阵不等宽 ASCII 白正(Times new Roman)



!"#\$%&!()*+,_.)01234567 89;===?@ABCDBFGHI JKLMMOPQRSTUVWX

12 点阵不等宽 ASCII 方头(Arial)

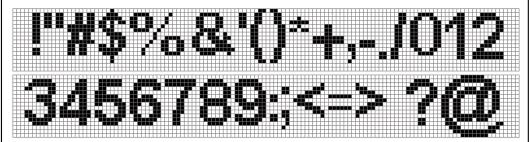
!"#\$%&:0*+,-./0123456 789;;<=>?@ABCDEFGH IJKLWNOPQRSTUVW



16 点阵不等宽 ASCII 白正(Times new Roman)

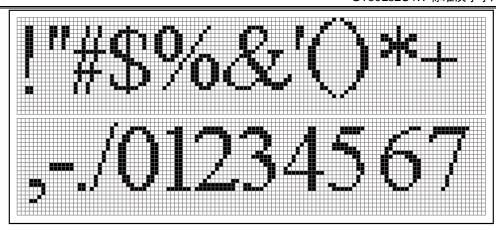
##\$%&\\)#+,-,/012 3456789:;<=>%

16 点阵不等宽 ASCII 方头 (Arial)

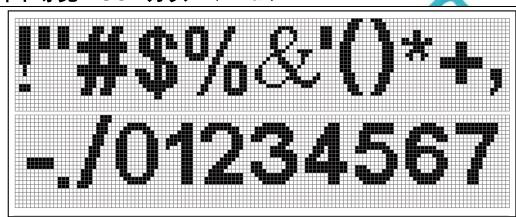


24 点阵不等宽 ASCII 白正(Times new Roman)

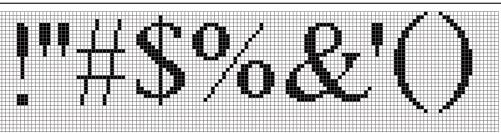




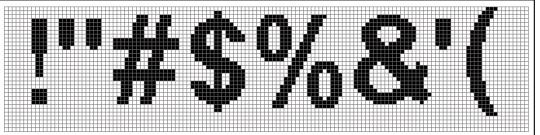
24 点阵不等宽 ASCII 方头 (Arial)



32 点阵不等宽 ASCII 白正(Time new Roman)



32 点阵不等宽 ASCII 方头(Arial)





2操作指令

2.1 指令参数

Instruction Set

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes	
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	_	1 to ∞	
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞	

所有对本芯片 SPI 接口的操作只有 2 个,那就是 Read Data Bytes (READ "一般读取")和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ "快速读取点阵数据")。.

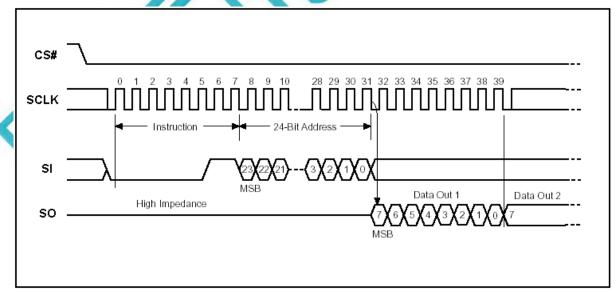
2.2 Read Data Bytes (一般读取)

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是 1 个字节的命令字(03 h)和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。
- 读取字节数据后,则把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。

如果片选信号(CS#)继续保持为底,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。

图: Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence





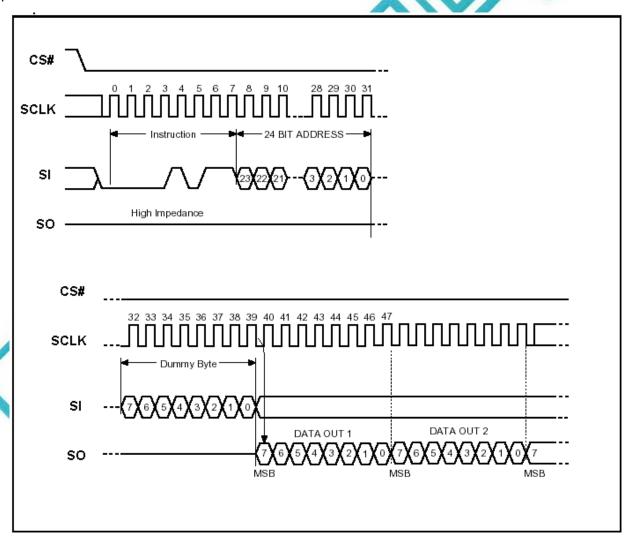
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是 1 个字节的命令字(0B h)和 3 个字节的地址以及 一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上 升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。
- 如果片选信号(CS#)继续保持为底,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。例:读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte,则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

如果不需要继续读取数据,则把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence

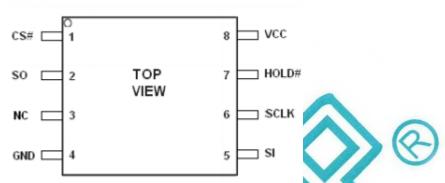




3 引脚描述与接口连接

3.1 引脚配置

SOP8-B



SOP8-B

NO.	名称	I/O	描述
1	CS#		片选输入(Chip enable input)
2	SO	0	串行数据输出 (Serial data output)
3	NC		悬空
4	GND		地(Ground)
5	SI		串行数据输入 (Serial data input)
6	SCLK		串行时钟输入(Serial clock input)
7	HOLD#		总线挂起(Hold, to pause the device without)
8	VCC <		电源(+ 3.3V Power Supply)

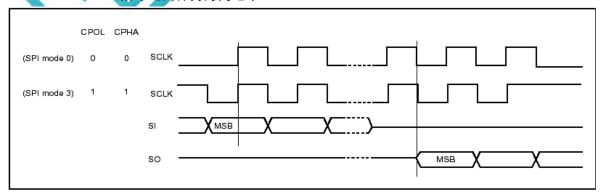
3.2 引脚描述

串行数据输出(SO): 该信号用来把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入(SI): 该信号用来把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。

串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。

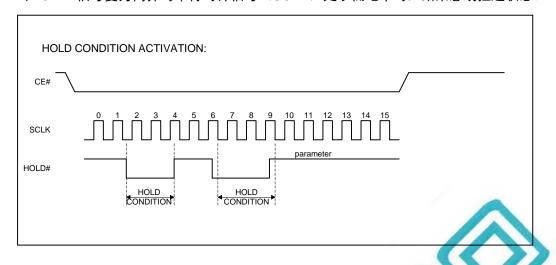
片选输入(**CS#**): 所有串行数据传输开始于CS#下降沿,CS#在传输期间必须保持为低电平,在两条 指令之间保持为高电平。



总线挂起输入(HOLD#):



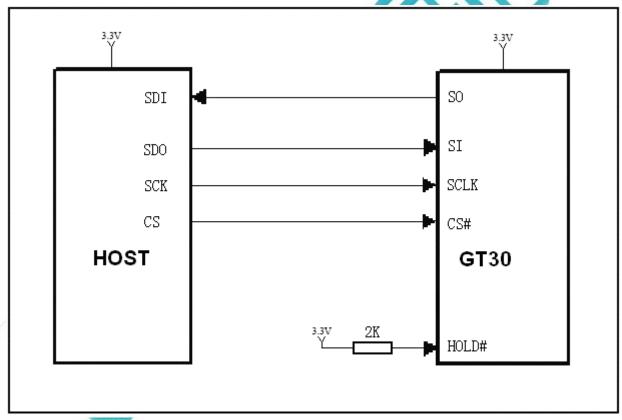
当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态。 当HOLD#信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。





3.3 HOST CPU 主机接口与 SPI 接口电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图 (#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高)。



HOST CPU 主机 SPI 接口电路示意图



4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
T _{OP}	Operating Temperature	-40	85	$^{\circ}$ C	SPI mode
T _{STG}	Storage Temperature	-55	125	$^{\circ}$ C	
VCC	Supply Voltage	-0.5	4.0	V	
V_{IN}	Input Voltage	-0.5	4.0	V	
GND	Power Ground	0	0	V	

4.2 DC 特性

Condition: $T_{OP} = -40^{\circ}C$ to $85^{\circ}C$, GND=0V in SPI mode;

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
I_{DD}	VCC Supply Current(active)		20	mA	
I _{SB}	VCC Standby Current		5	uA	
V_{IL}	Input LOW Voltage	-0.3	0.6	V	
V_{IH}	Input HIGH Voltage	0.7VCC	VCC+0.3	V	
V_{OL}	Output LOW Voltage		0.4 (I _{OL} =1.6mA)	V	V00 0 7V 0 0V
V _{OH}	Output HIGH Voltage	VCC-0.2 (I _{OH} =100uA)		V	VCC=2.7V-3.6V
ILI	Input Leakage Current	0	±2	uA	
I _{LO}	Output Leakage Current	0	±2	uA	

Note: IIL: Input LOW Current, IIH: Input HIGH Current,

I_{OL}: Output LOW Current, I_{OH}: Output HIGH Current,

4.3 AC 特性

4.3.1 SPI 接口模式下 AC 特性

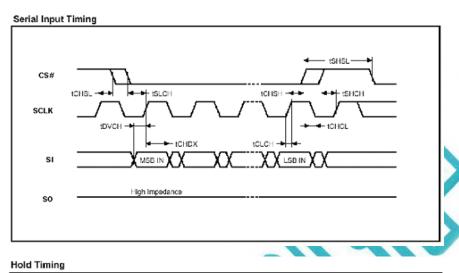
Condition: $T_{OP} = -20^{\circ}C$ to $85^{\circ}C$, VCC= 2.7V to 3.6V

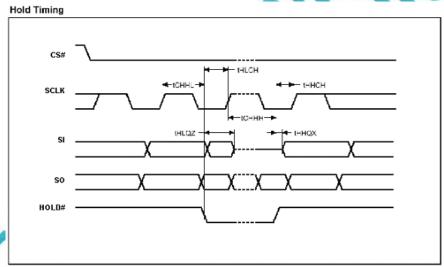
Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Max.	Unit
Fc	Fc	Clock Frequency	D.C.	80	MHz
tch	tCLH	Clock High Time	4		ns
tcL	tcll	Clock Low Time	4		ns
tclch		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2		V/ns
tchcL		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2		V/ns
tslch	tcss	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
tchsl		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
tovch	tosu	Data In Setup Time	2		ns
tchdx	tDH	Data In Hold Time	2		ns
t CHSH		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t shch		CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t shsl	tcsh	CS# Deselect Time	100		ns
t shqz	tois	Output Disable Time		6	ns
t clqv	t∨	Clock Low to Output Valid		7	ns

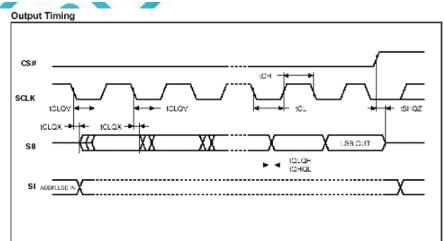
t clax	tно	Output Hold Time	0	ns



t HLCH		HOLD# Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t сннн		HOLD# Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t ннсн		HOLD Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t CHHL		HOLD Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t HHQX	tLZ	HOLD to Output Low-Z		6	ns
t HLQZ	tHZ	HOLD# to Output High-Z		6	ns



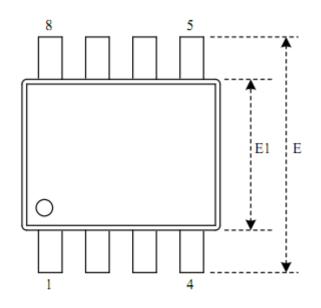


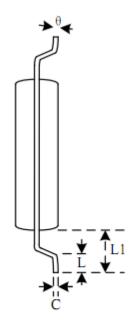


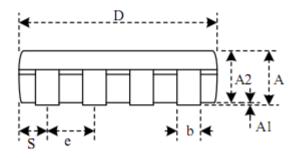


5 封装尺寸: SOP8-B

单位: mm









Dimensions

Symbol		Α	A1	A2	b	С	D	Е	E1	e	1	L1	s	θ
Unit			Α'	72	2)		•		0)	
	Min		0.05	1.70	0.36	0.19	5.13	7.70	5.18		0.50	1.21	0.62	0
mm	Nom		0.15	1.80	0.41	0.20	5.23	7.90	5.28	1.27	0.65	1.31	0.74	5
	Max	2.16	0.25	1.91	0.51	0.25	5.33	8.10	5.38		0.80	1.41	0.88	8
	Min		0.002	0.067	0.014	0.007	0.202	0.303	0.204		0.020	0.048	0.024	0
Inch	Nom		0.006	0.071	0.016	0.008	0.206	0.311	0.208	0.050	0.026	0.052	0.029	5
	Max	0.085	0.010	0.075	0.020	0.010	0.210	0.319	0.212		0.031	0.056	0.035	8

GOT●P高選[®] - 17 www.genitop.com

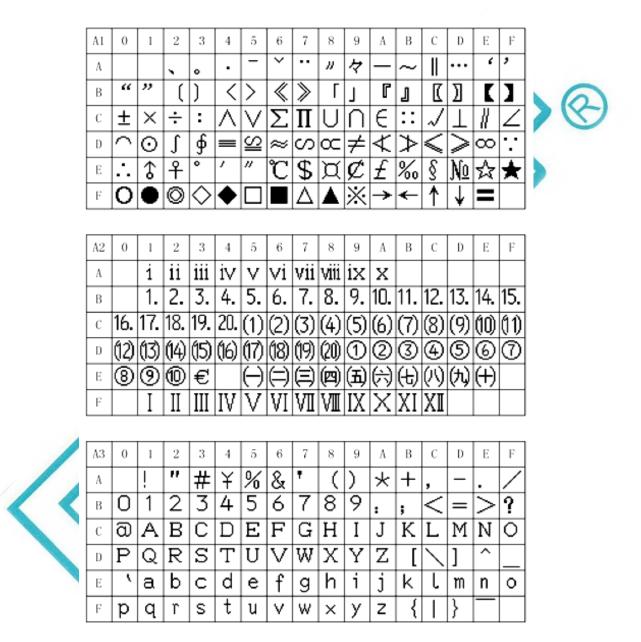


6 附录

6.1 GB2312 1 区字符 (846 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 846 个字符;

GB2312 1区





GB2312 1区







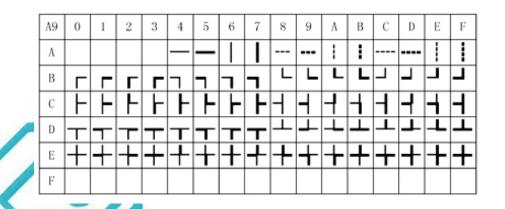




GB2312 1区





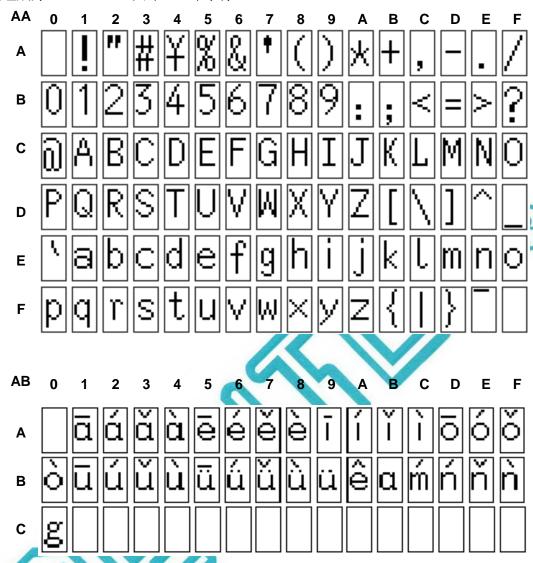






6.2 8×16 点国标扩展字符(126 字符)

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符

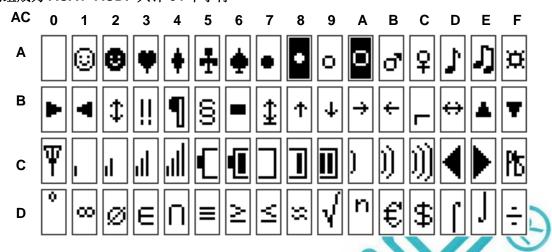


G□T●P高通[®] - 21 - www.genitop.com



6.3 8×16 点特殊字符 (64 字符)

内码组成为 ACA1~ACDF 共计 64 个字符





G□T●P高通[®] - 22 - www.genitop.com